

AP-1000を用いたデバイスのパッケージ開封

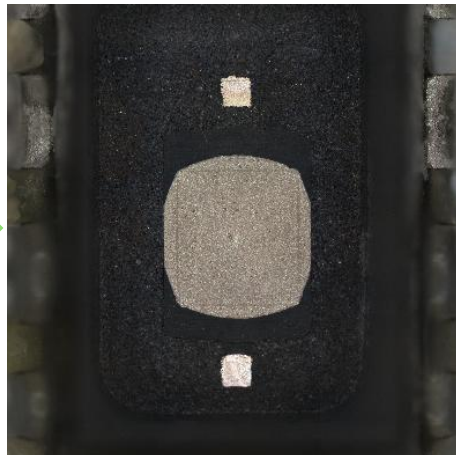
使用ツール：エンドミル

配線露出



使用ツール：ダイヤモンドバー

導電性接着剤露出



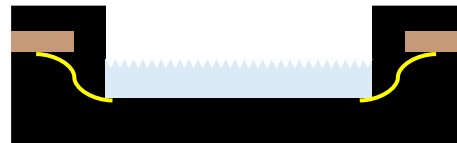
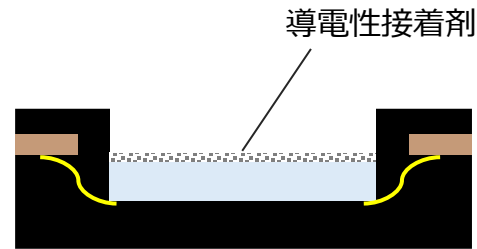
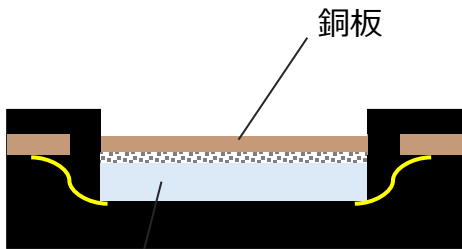
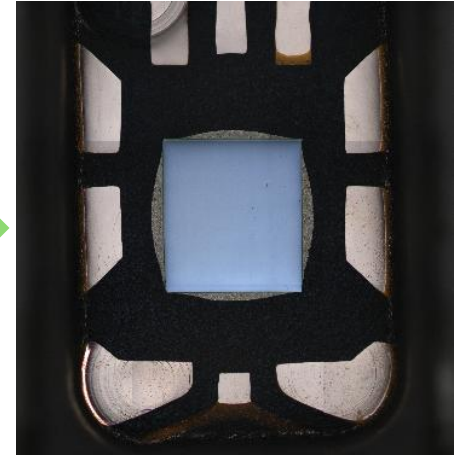
使用ツール：ダイヤモンドバー

基板露出



使用ツール：研磨パッド

鏡面加工



ICチップ

SUNYOU